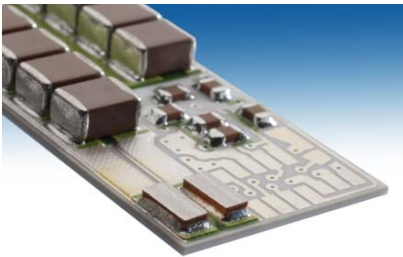


## **Mehr Power für die Elektromobilität Heraeus entwickelt eine Vielzahl von plattierten Verbundwerkstoffen für Zukunftstechnologien in der Automobilindustrie**



Alternative Energie-Systeme und umweltfreundliche Antriebskonzepte wie Hybrid-Technik für Fahrzeuge aller Art erfordern zuverlässige und multifunktionale Systeme. Zunehmend komplexe Funktionalitäten müssen auf engstem Raum, bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit, zusammengefasst werden. Mit walzplattierten Bandhalbzeugen und oberflächenbeschichteten Bondpads bietet W. C.

Heraeus kundenorientierte Lösungsansätze für diese Zukunftstechnologien.

„Heraeus AlSi:Bond walzplattierte Bänder“ zeichnen sich besonders durch ihre Leistungsstärke bei der Übertragung hoher Ströme, sowie durch ihre Robustheit für anspruchsvolle Anwendungen aus. Aufgrund dieser speziellen Eigenschaften und der relativ unproblematischen Verarbeitung werden sie verstärkt in der Leistungselektronik und in der Automobilindustrie eingesetzt. Walzplattierte Bänder mit einer Aluminium-Silizium-Oberfläche auf einem Kupferträgerband ermöglichen zuverlässige Bondverbindungen in Hybridbauteilen und haben sich bereits in Millionen Fahrzeugen bewährt. Die Bänder werden sowohl für Dünn- und Dickdrahtbondungen von 50µm bis 500µm als auch für Bändchenbondungen gleichermaßen eingesetzt.

### **Heraeus entwickelt vielfältige plattierte Verbundwerkstoffe**

Der Prozess des Walzplattierens ermöglicht eine Verbindung von bis zu 12 verschiedenen streifenförmigen Kontaktwerkstoffen nebeneinander auf einem Trägerband. Im Vergleich zu galvanischen Prozessen für Oberflächenbeschichtungen lassen sich durch das Walzplattieren sehr duktile Schichten herstellen, wobei dem geometrischen Design kaum Grenzen gesetzt sind. Durch die Kombination von Walzplattierprozessen mit bekannten Oberflächenveredlungsverfahren wie selektiver galvanischer Beschichtung oder Sputtern werden die Produkte auch besonders anspruchsvollen Funktionsanforderungen gerecht.

Ähnliche Eigenschaften bieten auch „Heraeus AlSi:Pad oberflächenbeschichtete Bondpads“. Sie ermöglichen in der Aufbau- und Verbindungstechnik die Nutzung der guten Eigenschaften der Aluminium-Silizium-Oberfläche für Bondverbindungen auf Leiterplatten und Keramikhybriden. Aufgrund der SMT-tauglichen Verpackung bieten sie eine leichte und sichere Verarbeitbarkeit für den Bestückungsprozess. Durch den Einsatz entsteht ein durchgängiges Monometallsystem für die komplette Bondverbindung zwischen Leadframe und Elektronik.

---

Die W. C. Heraeus GmbH verarbeitet weltweit die Edelmetalle Gold, Silber und Platin und andere Platingruppenmetallen sowie die Sondermetalle Rhenium, Tantal, Niob und Beryllium primär zu industriellen Produkten für die Automobil-, Halbleiter-, Elektronik- und Medizinindustrie. Ein globaler Verbund aus über 30 Gesellschaften umfasst Fertigungsstätten für alle Stufen der Edelmetallgewinnung und -verarbeitung. W. C. Heraeus nimmt im industriellen Edelmetallhandel international eine herausragende Position ein.

Der Edelmetall- und Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen mit über 155-jähriger Tradition. Unsere Geschäftsfelder umfassen die Bereiche Edelmetalle, Sensoren, Dentalprodukte, Biomaterialien, Quarzglas und Speziallichtquellen. Mit einem Produktumsatz von rund 3 Mrd. € und einem Edelmetallhandelsumsatz von 13 Mrd. € sowie weltweit knapp 13000 Mitarbeitern in über 110 Gesellschaften hat Heraeus eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten.

**Leserkontakt:**

Jennifer Pieroth  
Packaging Technology  
W. C. Heraeus GmbH  
Heraeusstraße 12-14  
63450 Hanau, Germany

Phone: + 49 (0) 6181.35-4320  
Fax: + 49 (0) 6181.35-16 4320  
Email: [jennifer.pieroth@heraeus.com](mailto:jennifer.pieroth@heraeus.com)  
Web: [www.heraeus-packaging-technology.com](http://www.heraeus-packaging-technology.com)

**Pressekontakt:**

Tom Grunwaldt  
Marketing & Communication Services  
W. C. Heraeus GmbH  
Heraeusstraße 12-14  
63450 Hanau, Germany

Phone: + 49 (0) 6181.35-5433  
Fax: + 49 (0) 6181.35-3131  
E-Mail: [tom.grunwaldt@heraeus.com](mailto:tom.grunwaldt@heraeus.com)  
Web: [www.wc-heraeus.de](http://www.wc-heraeus.de)